

日本企業對台灣投資動向

台灣・日本（九州）經濟交流論壇2024

2024年3月12日

瑞穗銀行 執行理事

台北・台中・高雄分行 總經理 村田 温

MIZUHO

日本企業對台灣投資動向

聚焦於半導體相關、能源、消費領域

日本對台灣重大投資案例（2021年以後由經濟部公布）

No	公布日	公司名	投資金額	概要
01	21/01/28	(株)日立製作所	15億TWD	增資台灣子公司
02	21/04/28	(株)VITEC ENESTA	8億TWD	增資台灣子公司
03	21/08/25	三井不動產(株)	10億TWD	增資台灣子公司
04	22/01/24	(株)日立製作所	約246.7億TWD	M&A
05	22/09/26	東京海上日動火災保險(株)	約73.8億TWD	增資台灣子公司
06	22/12/26	東京海上日動火災保險(株)	約26.6億TWD	增資台灣子公司
07	23/01/18	Japan Renewable Energy(株)	2億TWD	增資台灣子公司
08	23/02/24	東京海上日動火災保險(株)	40.1億TWD	增資台灣子公司
09	23/05/30	東京海上日動火災保險(株)	60.21億TWD	增資台灣子公司
10	23/06/27	日東紡績(株)	20億TWD	增資台灣子公司
11	23/09/18	日商REFINE HOLDINGS CO., Ltd..	3億9千TWD	增資台灣子公司

日商對台灣的投資案例（依據2022年以後公布的資料彙整而成）

半導體原材料及設備佔投資大部分，2022年達到有史以來最高投資金額17億USD。

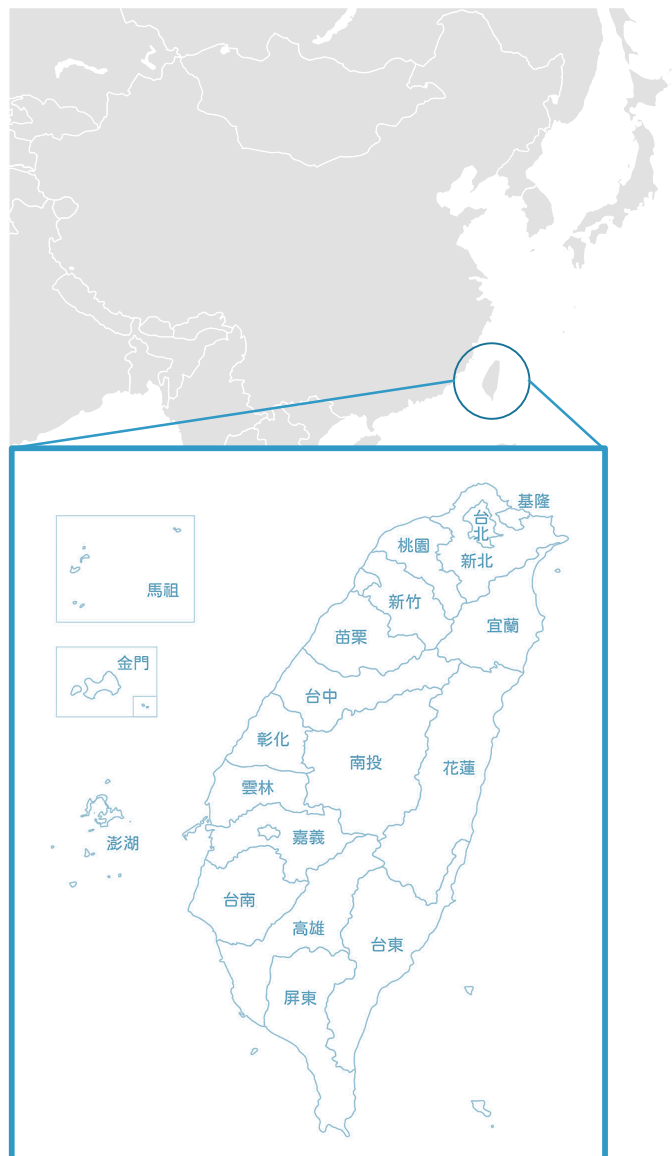
領域	企業	公布年月
半導體	(株)ADEKA	2022/02
	(株)FUJIMI INCORPORATED	2022/02
	JX金屬(株)	2022/02
	(株)RS Technologies	2022/02
	KIOXIA(株)	2022/03
	Mitsubishi Gas Chemical (株)	2022/03
	JSR(株)	2022/03
	(株)Tri Chemical Laboratories	2022/04
	TOCALO(株)	2022/05
	田中貴金屬工業(株)	2022/07
	Showa Denko Materials (株)	2022/09
	Showa Denko Materials (株)	2022/09
	Central Glass(株)	2022/09
	Tokyo Electron(株)	2022/11
	(株)ADVANTEST	2023/01
	GIGAPHOTON(株)	2023/01
	AIR WATER(株)	2023/02
JX金屬(株)	2023/03	
(株)荏原製作所	2023/04	

領域	企業	公布年月
半導體	Fujifilm(株)	2023/05
	AGC(株)	2023/06
	(株)Hitachi hightech	2023/06
	EW COSMOS ELECTRIC(株)	2023/07
	Fujiibo Holdings(株)	2023/10
	大陽日酸(株)	2023/11

領域	企業	公布年月
能源	Sustainable battery solutions(株)	2022/03
	Toho Gas(株)、(株)商船三井、北陸電力(株)	2022/03
	(株)商船三井	2022/03
	三井物產	2023/09
消費	Alinamin Pharmaceutica(株)	2022/04
	(株)Snow Peak	2022/12
	(株)LOPIA	2023/01
	(株)Residential Real Estate	2023/03
	(株)肥後銀行	2023/06
	西日本鐵道(株)	2023/08
三起商行(株)	2023/09	

台灣經濟概況

概況：略小於九州的面積裡，約2倍的人口。世界第21的GDP，第4的外匯存底



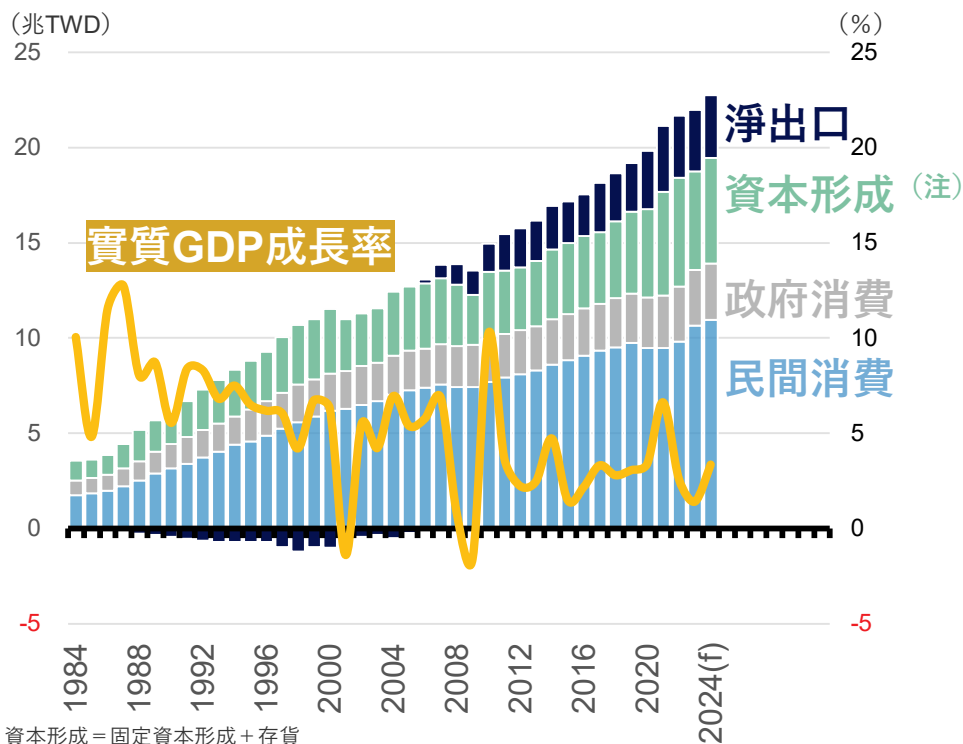
基礎資訊

面積	36,197km ² (日本377,974 km ² 的約10分之1，九州42,230 km ² 相比略小)
人口	2,342 萬人 (24年1月)
首都	台北市約 251 萬人 (其他，台中市約285萬人、高雄市約274萬人) (24年1月)
GDP	名目GDP 7,605 億USD (世界第21名、22年) 人均名目GDP 32,687 USD (世界第34名、22年)
外匯存底	5,695 億USD (24年1月) (22年12月時 世界第4 名。次於中國大陸、日本、瑞士)
產業構造	<ul style="list-style-type: none">名目GDP的各行業占比 農業 1.5%、工業 36.8%、服務業 61.7% (23年)工業主要為半導體製造，服務業主要為批發·零售業和房地產等
日系經濟團體數	台北市日本工商會會員： 490 家 (23年3月) 台灣日本人會法人會員： 263 家 (22年12月)
在台日人數	21,262 人 (24年1月)

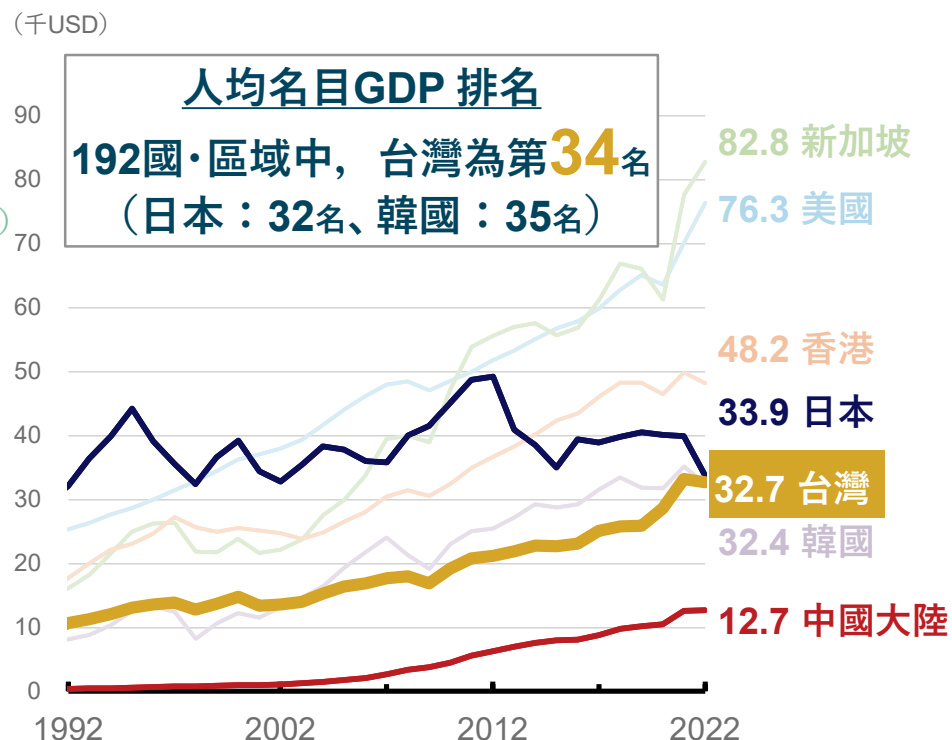
GDP：由強勁的民間消費支撐，並由出口和投資驅動

- **民間消費**約佔GDP的一半。電子零組件等出口以及半導體需求暢旺帶動投資，驅動GDP成長
- **人均GDP**也逐年成長，**2022年時達到3萬2,700USD，與日本相當**
- **2023年的餐飲·零售業營業額再創新高**
以半導體及能源為中心的對台投資力道持續強勁

實質GDP各構成要素的趨勢



人均名目GDP的趨勢 (2022年)



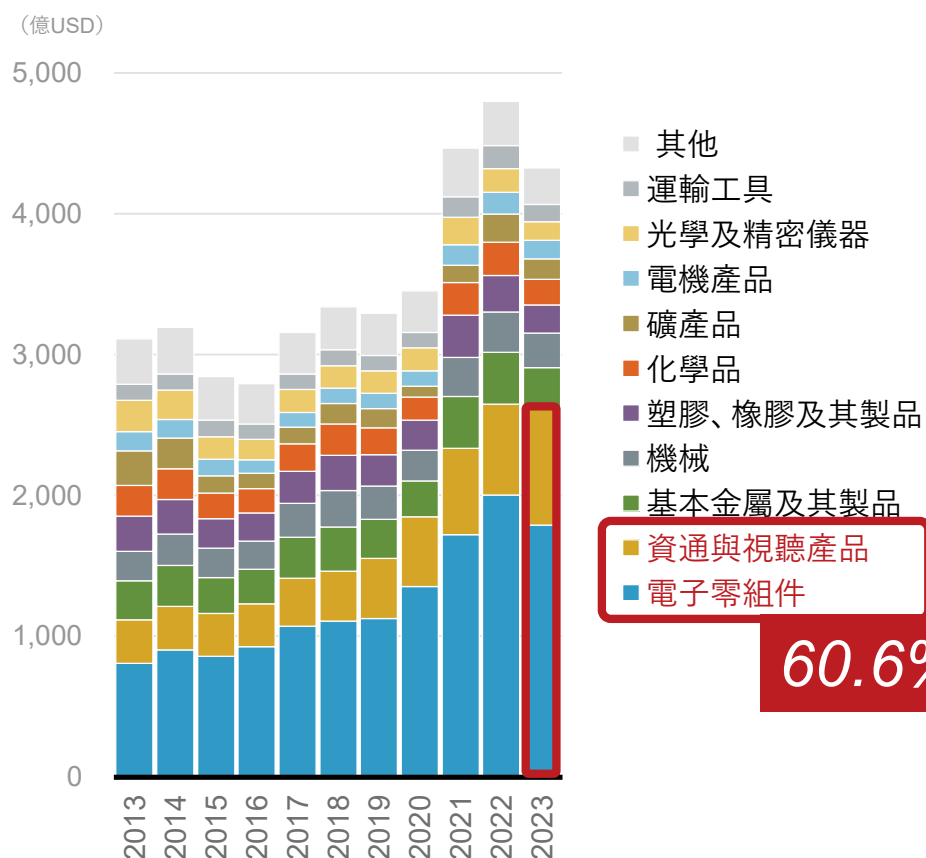
貿易以電機電子等高附加價值的加工貿易型態為主

- 出口：「**電子零組件**」，「**資通與視聽產品**」， **60.6%**

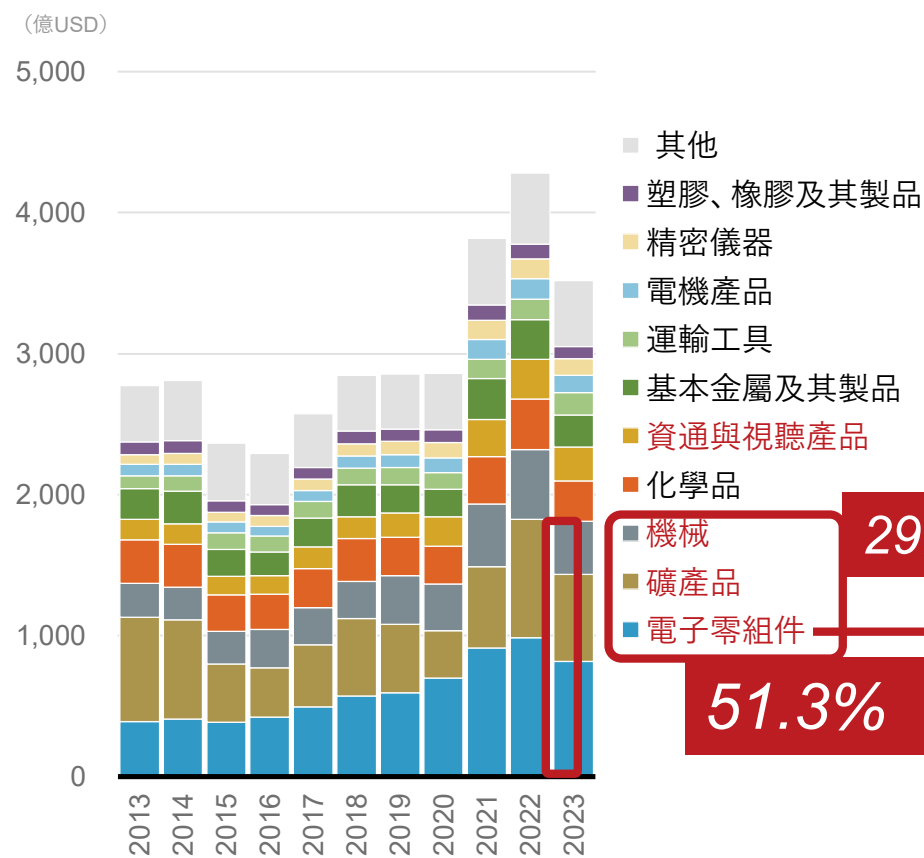
- 進口：「**電子零組件**」「**礦產品**」「**機械**」， **51.3%**

推測是用於製造電機電子零組件的原材料之進口，或出口的半導體成品之進口

出口趨勢（貨品分類）



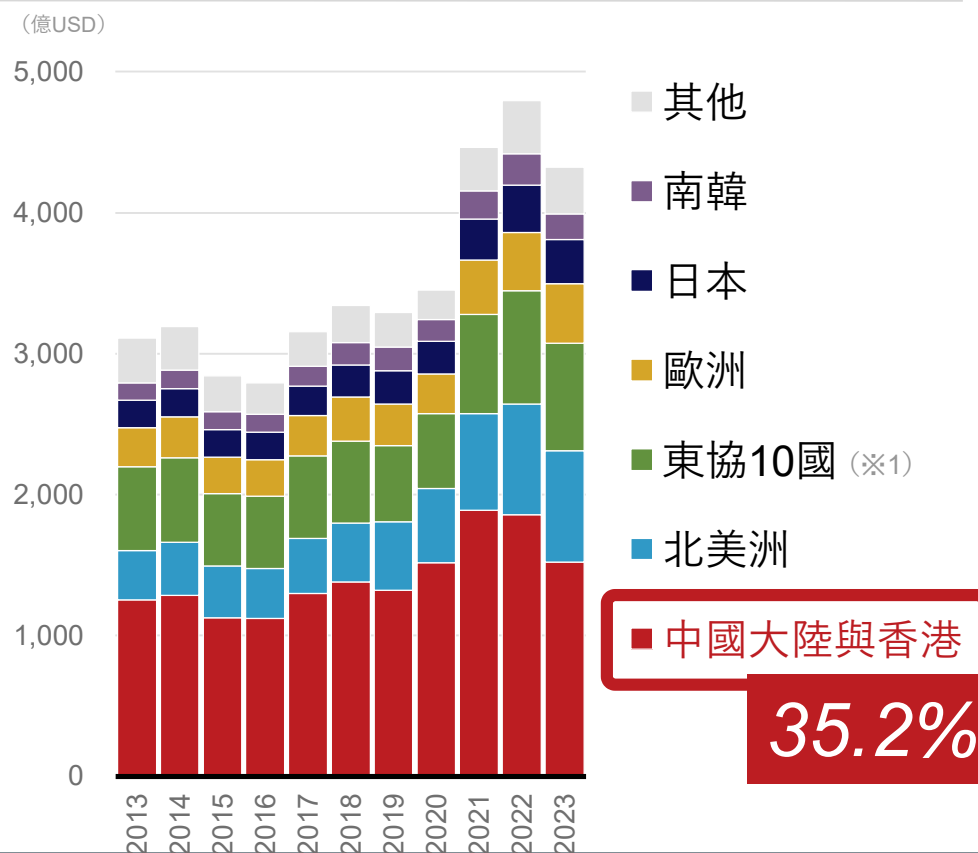
進口趨勢（貨品分類）



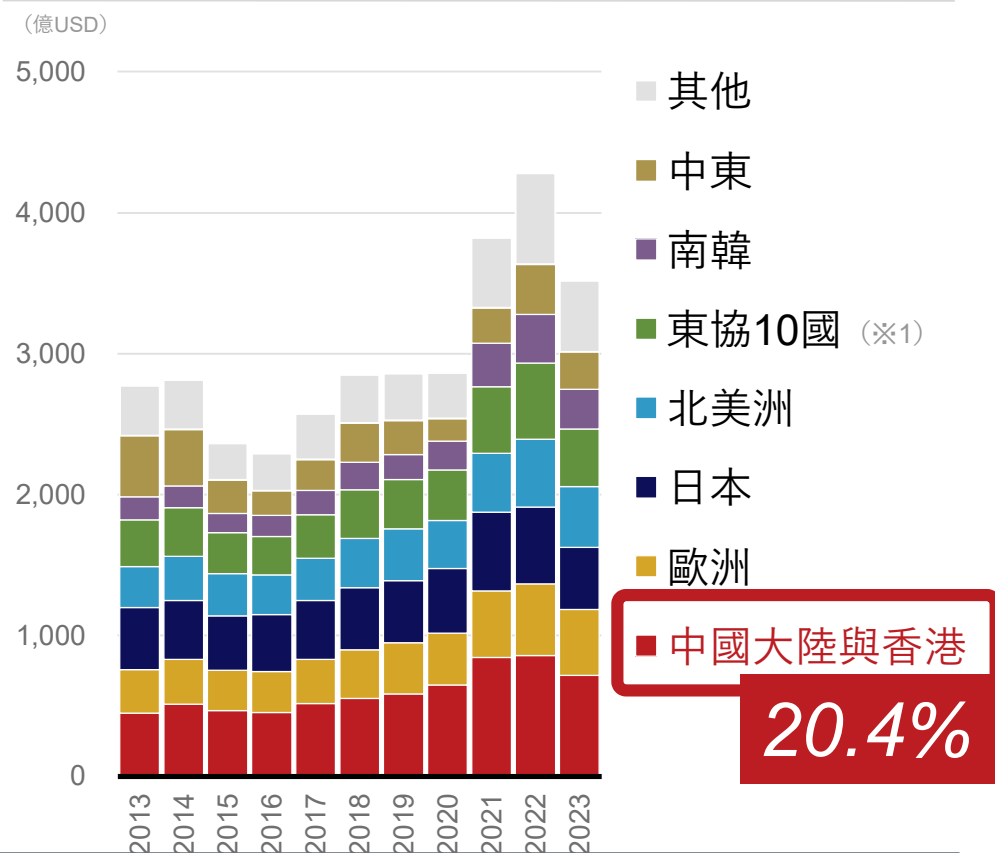
最大的貿易夥伴為中國大陸與香港

- 出口從**2021年史上最高金額的1,889億USD**降至**2023年的1,522億USD**。
主要原因：全球供應鏈重組及中國經濟失速帶來的影響（財政部）

出口趨勢（地區分類）



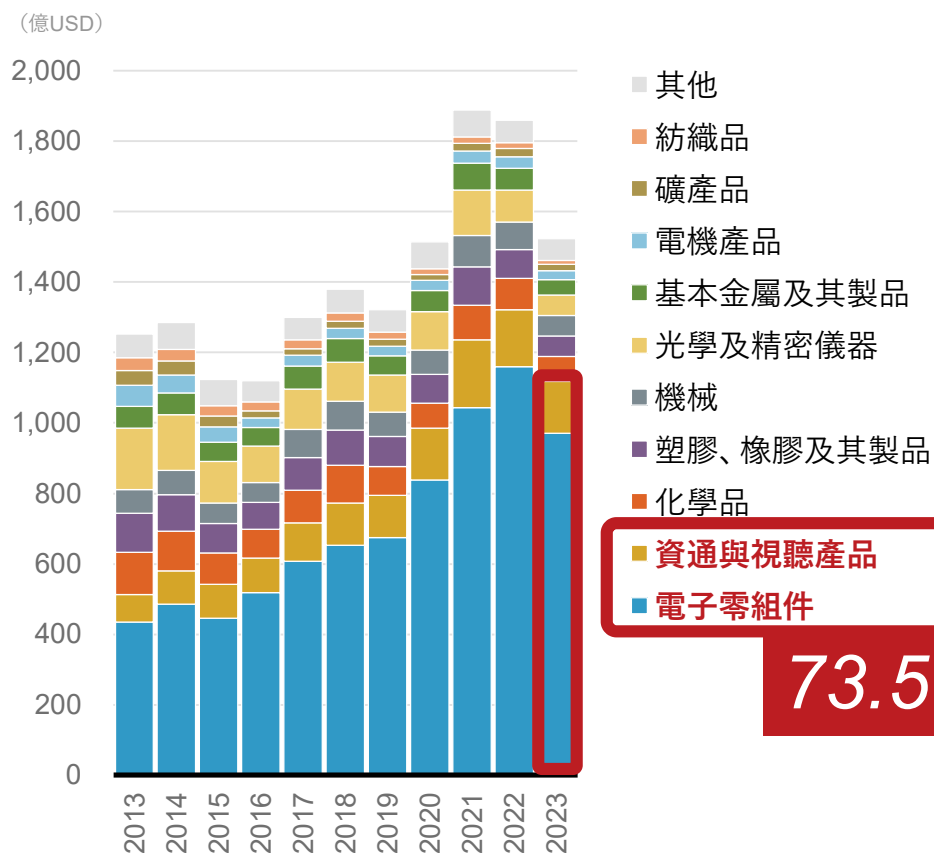
進口趨勢（地區分類）



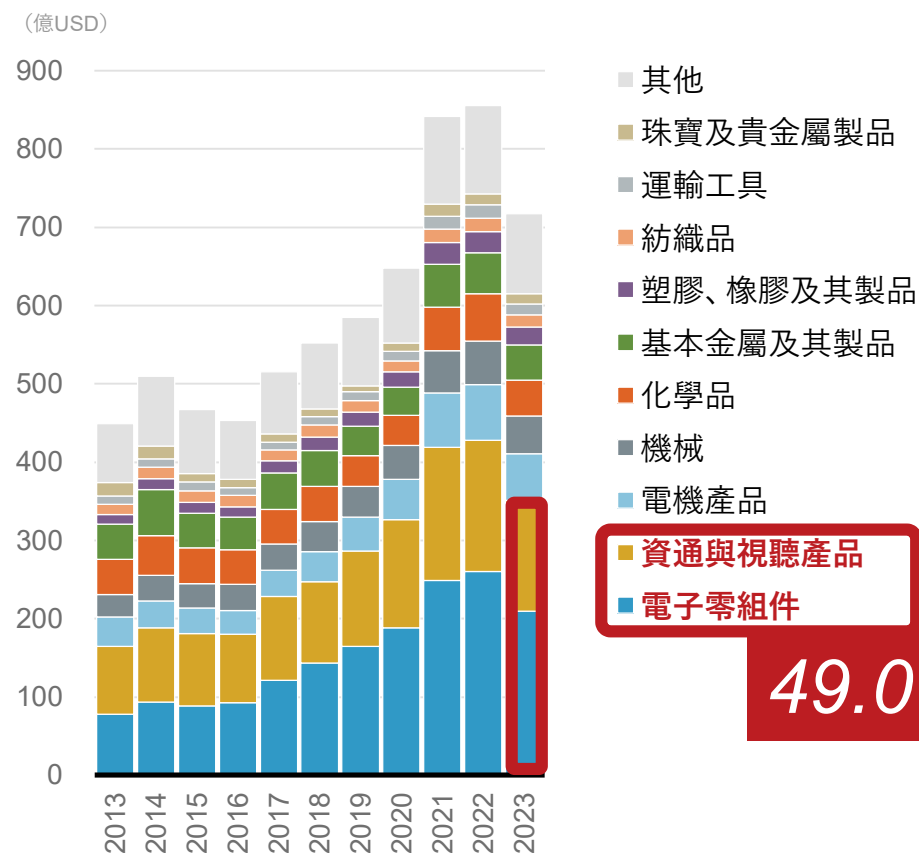
台灣是原材料及零件的供應基地，中國大陸是產品組裝工廠

- 出口：「**電子零組件**」，「**資通與視聽產品**」，佔**73.5%**。半導體與IC佔了大部分
- 進口：「**電子零組件**」，「**資通與視聽產品**」，佔**49.0%**。進口半導體最終製品

對中國大陸出口主要貨品



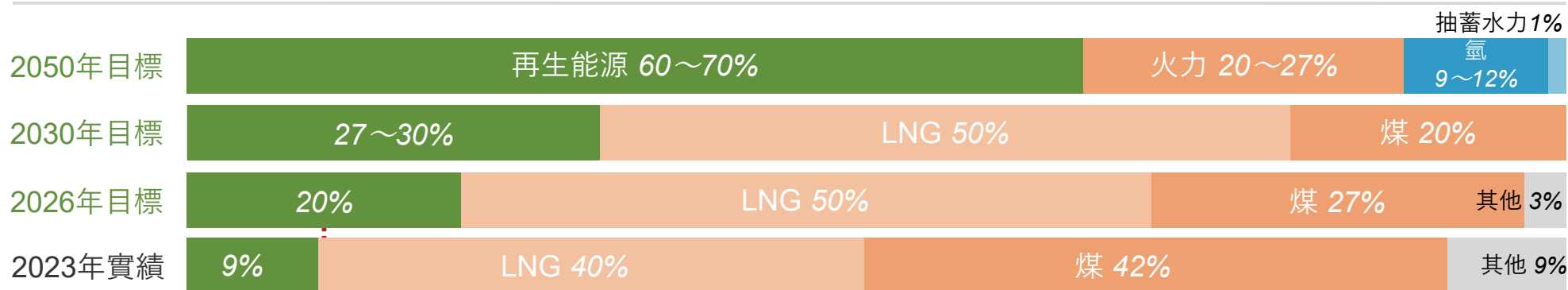
自中國大陸進口主要貨品



到2050年為止各階段的能源組合以及再生能源的發電目標

- 政府再生能源發電佔比目標：**2026年20%、2030年 27~30%、2050年 60~70%**

2023年以後的能源組合



再生能源裝置容量目標 (2025年)

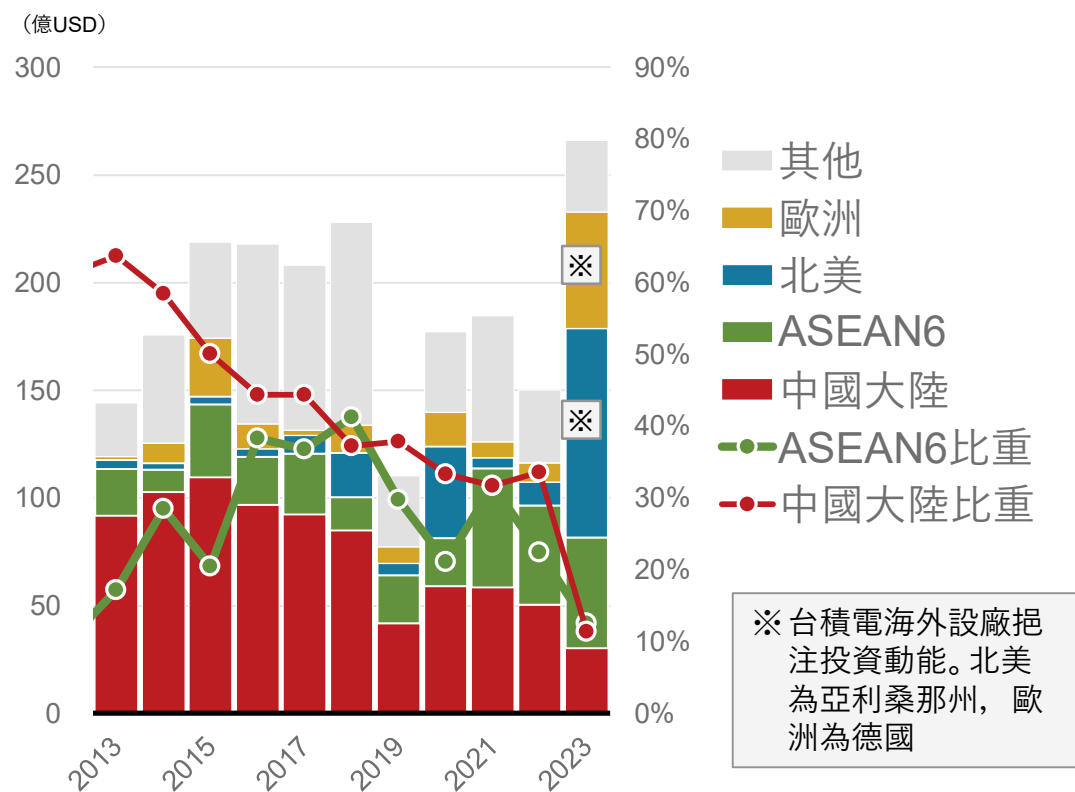


台灣・日本的投資狀況

台灣企業對外直接投資版圖從中國大陸市場走向國際多角化

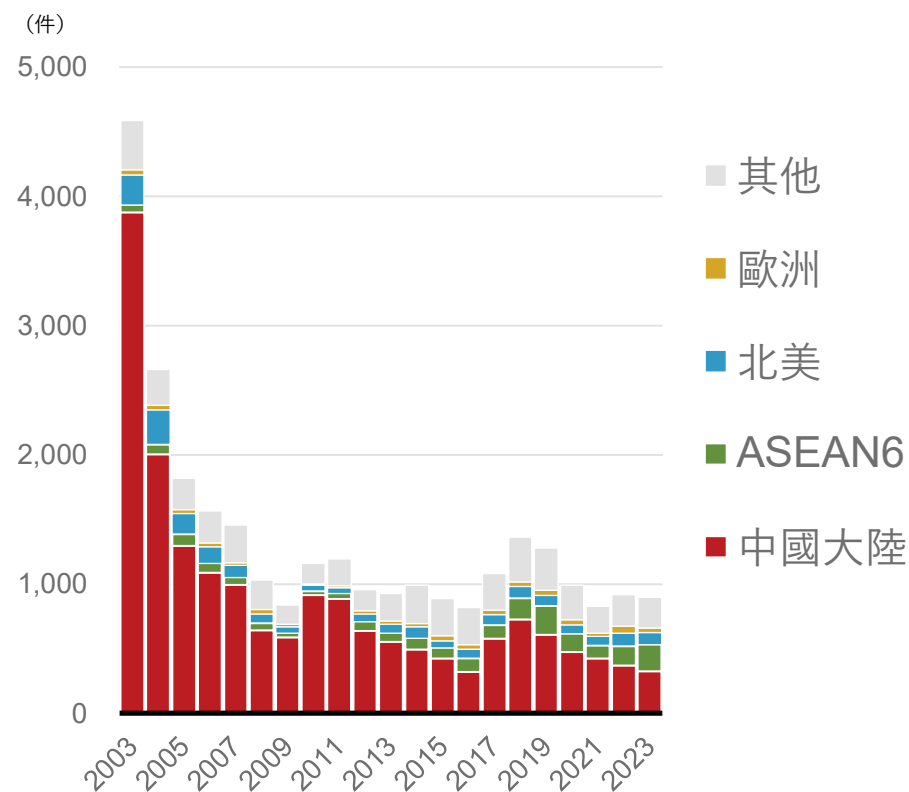
- 對中國大陸投資的**金額與件數都在減少**
- 對ASEAN6^(注)的投資額在2023年時超越對中國大陸的投資規模。
主要原因：①**投資成本增加**，②**中國經濟失速**，③**供應鏈重組**，④**地緣政治風險**，等

對外直接投資-按地區分 (金額)



(注) 東協六國包含新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南

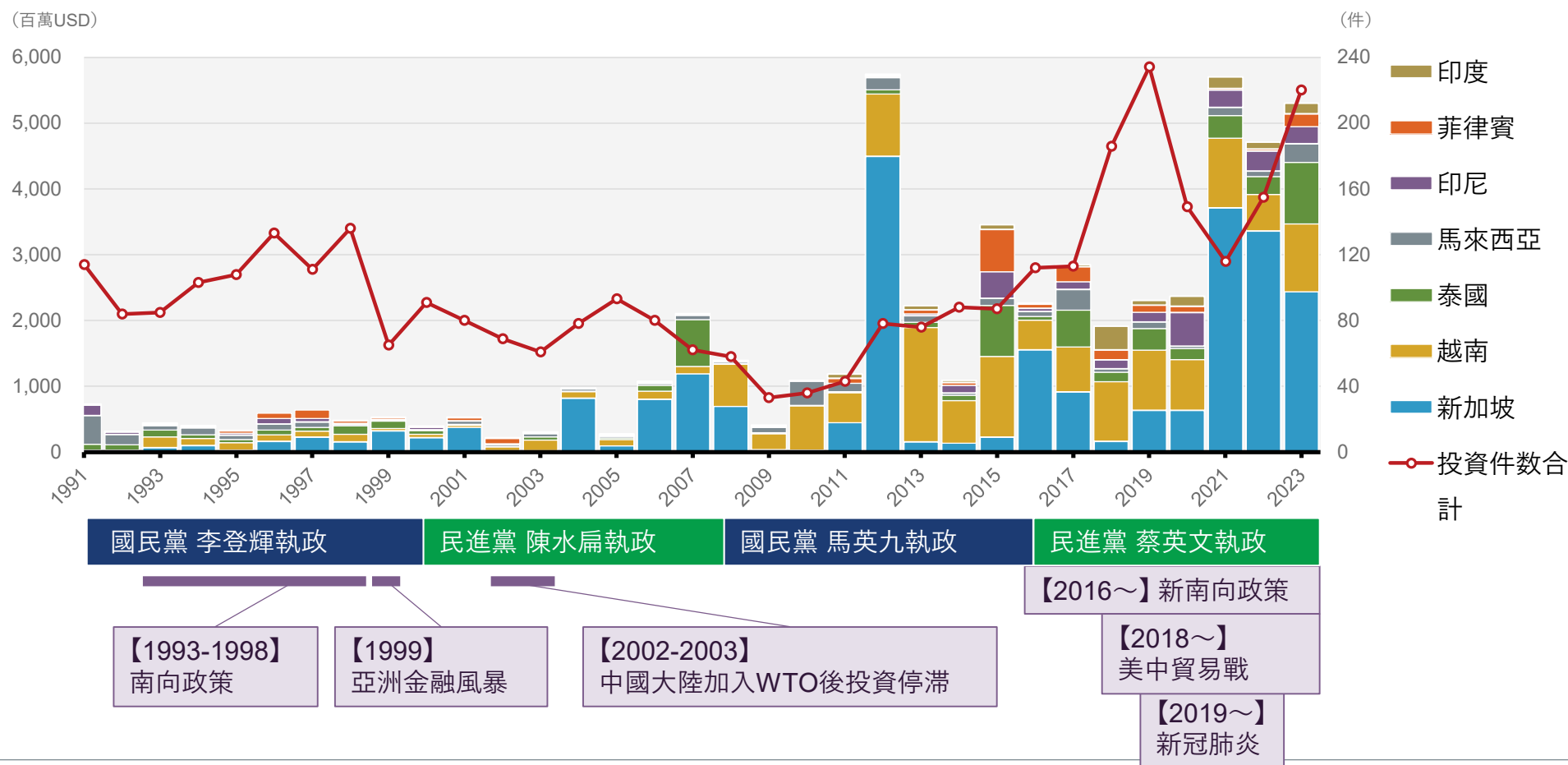
對外直接投資-按地區分 (件數)



台灣企業加速進軍東南亞市場，近年來集中在越南與新加坡

- 越南：過去聚焦於化學，紡織等領域。2019年以後對於**電子領域的投資增加**
- 新加坡：**控股公司等統籌公司的成立**及**金融・保險相關**的投資受到矚目

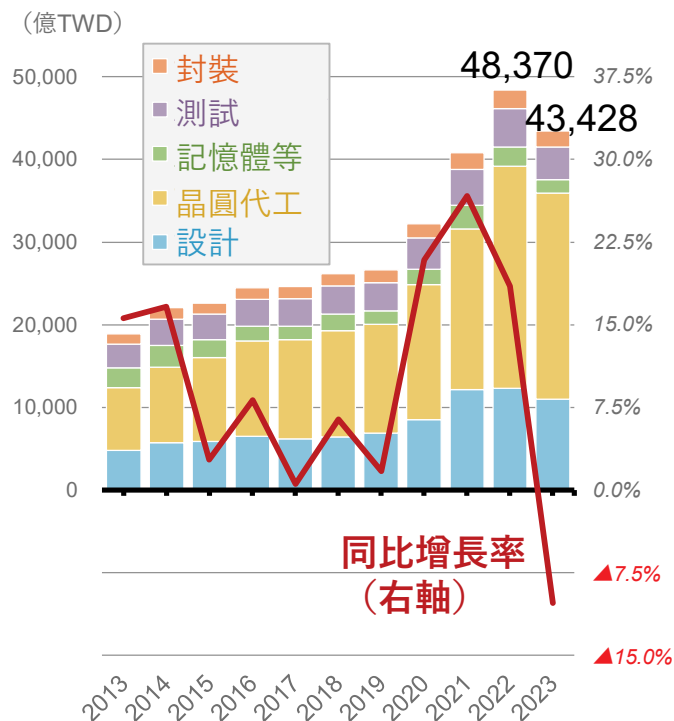
對東南亞主要國家的直接投資趨勢



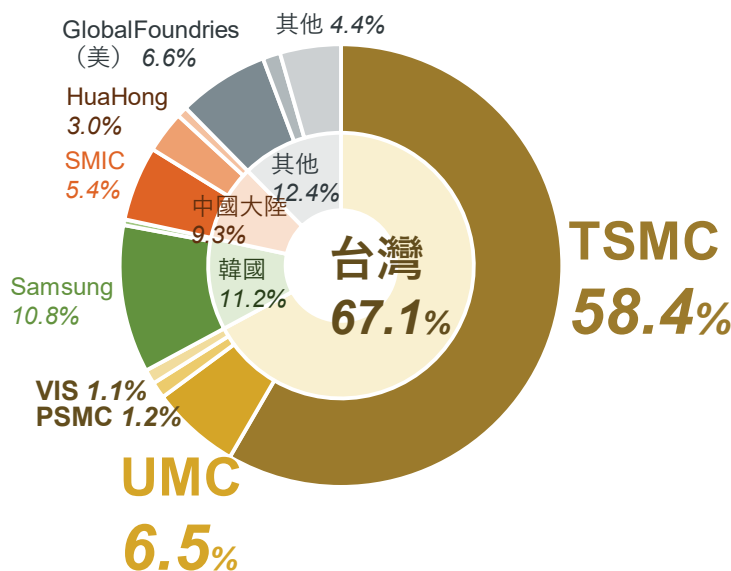
台灣的半導體產業①：市場趨於成長，台灣為半導體之製造重地

- IC產業產值：**2022年達到創紀錄的TWD4兆8,370億**。2023年較前一年減少▲10.2%，仍為歷來第二
- TSMC的全球市佔率為，**58.4%**
- 半導體BIG3中，TSMC的設備投資額超過300億USD，高於Intel，接近Samsung的規模（若僅限於晶圓代工，**TSMC的投資金額推測為最大**）

台灣的歷年IC產值

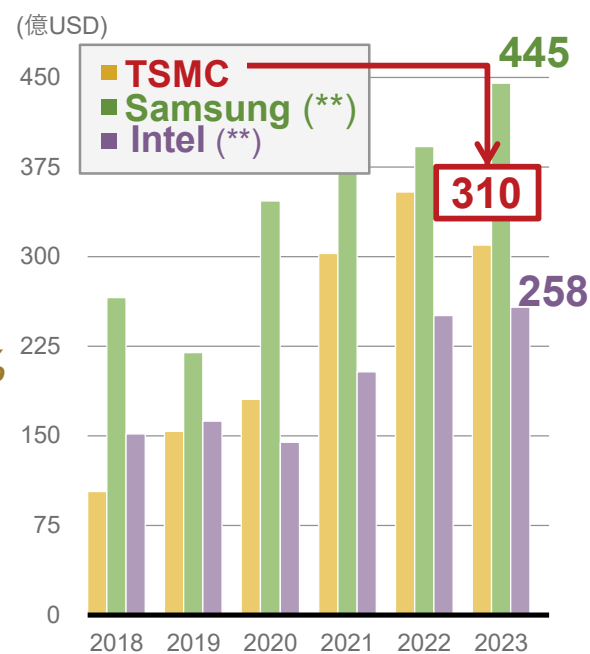


全球晶圓代工市場市佔率 (2023年1-6月)



(注) 由於原始數據的限制，DB HiTek為1-3月的資料

BIG3的設備投資額(*) (合併)



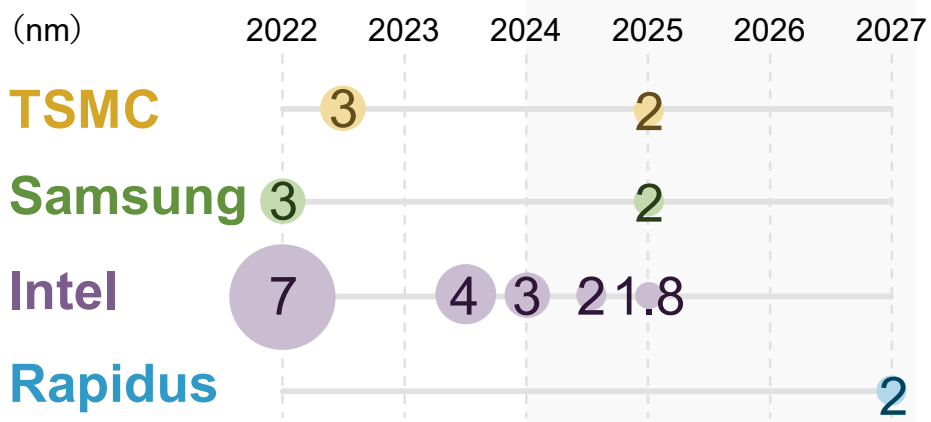
(*) 出自Refinitiv

(**) Samsung和Intel包括非代工業務的設備投資額

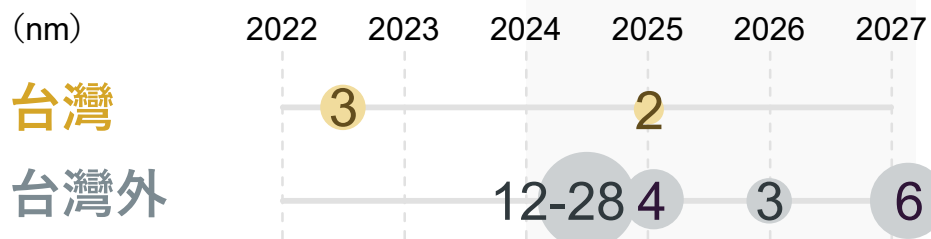
台灣的半導體產業②：無論技術或產能，TSMC之製造據點仍以台灣為中心

- 在先進製程的開發與量產中，TSMC一直領先業界。**目標2025年在台開始量產2奈米**
- TSMC的產能約9成皆在台灣**。即使今後在世界各地興建工場，**也不會改變絕大部分產能在台灣的現況**

各公司先進邏輯IC量產開始時間



TSMC先進邏輯IC量產開始時間



TSMC現有工廠和新建工廠的台灣內外比較

(1) 現有工場：月生產能力：125萬片以上 (2022年)

台灣內	生產能力：全體的約9成
台灣外	生產能力：全體的約1成

即使包括新建計劃在內，臺灣外的產能為每月約32萬片

(2) 新建工廠（台灣內）

地點	製品	月生產能力	量產預定
新竹	(建設中) 2nm	n.a.	公司整體目標 2025年開始量產2nm
台中	(計畫) n.a.	n.a.	
高雄	(建設中) 2nm	n.a.	

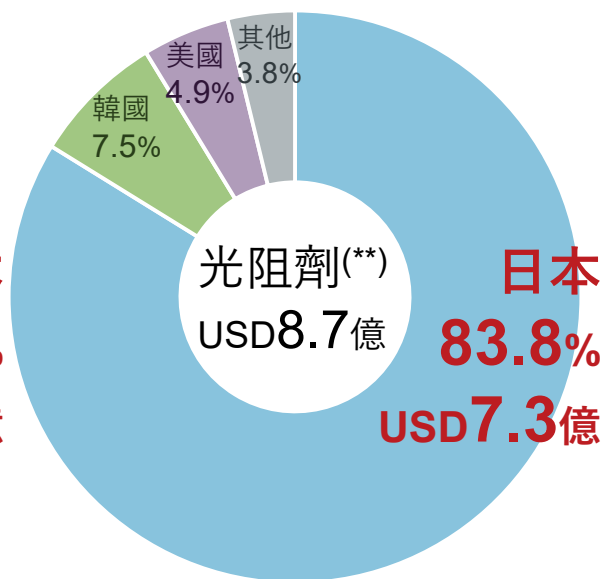
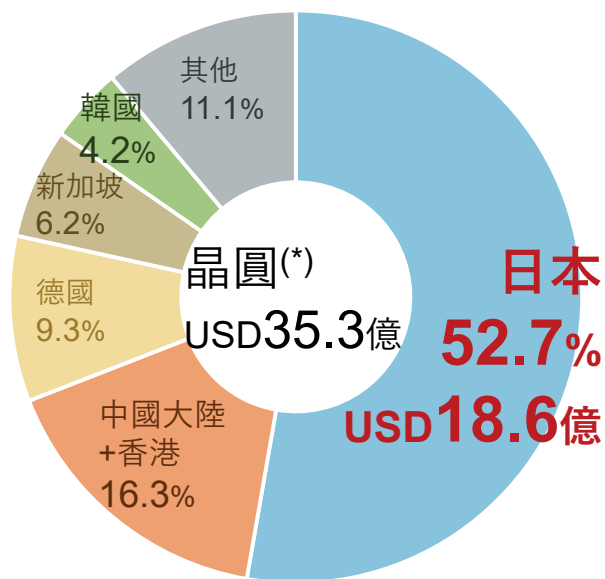
(3) 新建工廠（台灣外）

地點	製品	月生產能力	量產預定
美·亞利桑那	(建設中) 3、4nm	5萬片以上	2024年4奈米 2026年3奈米
日·熊本[一廠]	(建設中) 12、16、22、28nm	[一廠+二廠] 10萬片以上	2024年底
[二廠]	(計畫) 6、7nm等		2027年底
德·德勒斯登	(計畫) 12、16、22、28nm	約4萬	2027年底

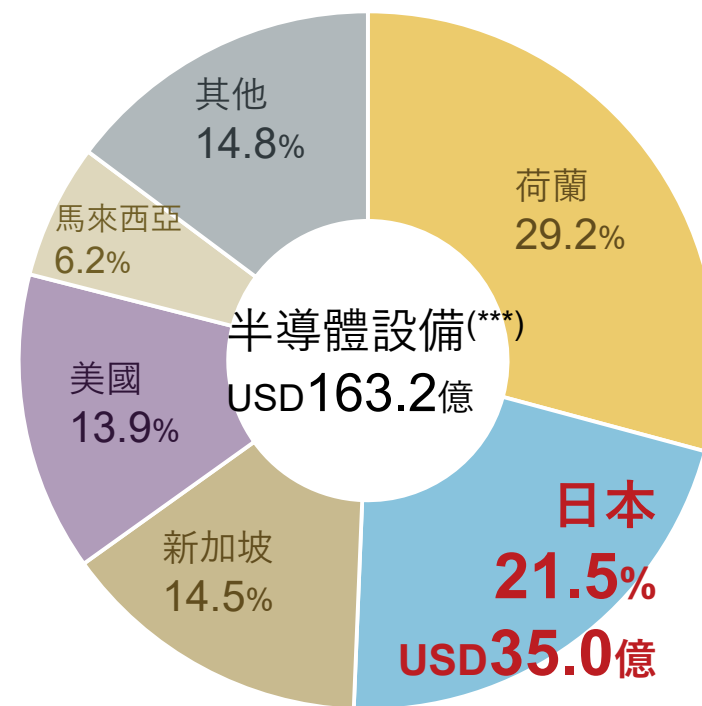
圍繞半導體的對日貿易關係 – 材料和設備重要進口來源國的日本

- **日本**是台灣第**3**大半導體出口或進口國
- **日本作為半導體原材料及設備的進口國**具有很大的存在感

台灣的半導體材料進口來源 (2023年※)



台灣的半導體設備進口來源 (2023年※)



(※) 1-11月(正式值)和12月(初步值)的合計

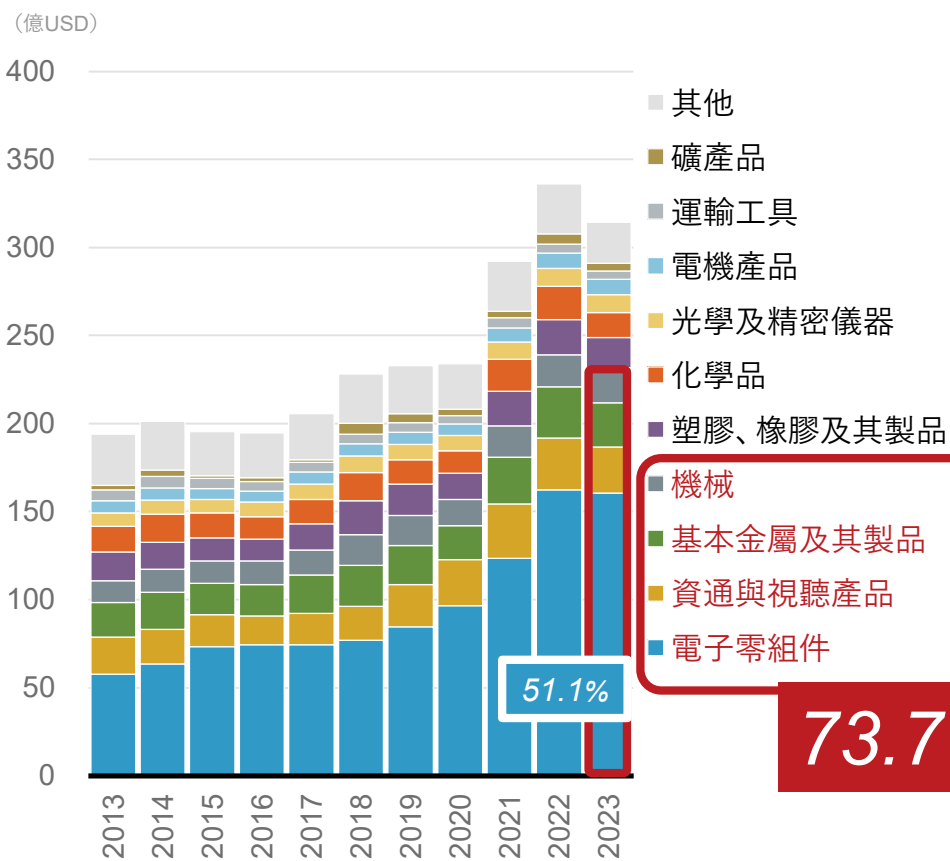
(*) HS Code 381800 (**) 同 370790

(***) HS Code 848610、848620、848640、903082、903141、903180之合計

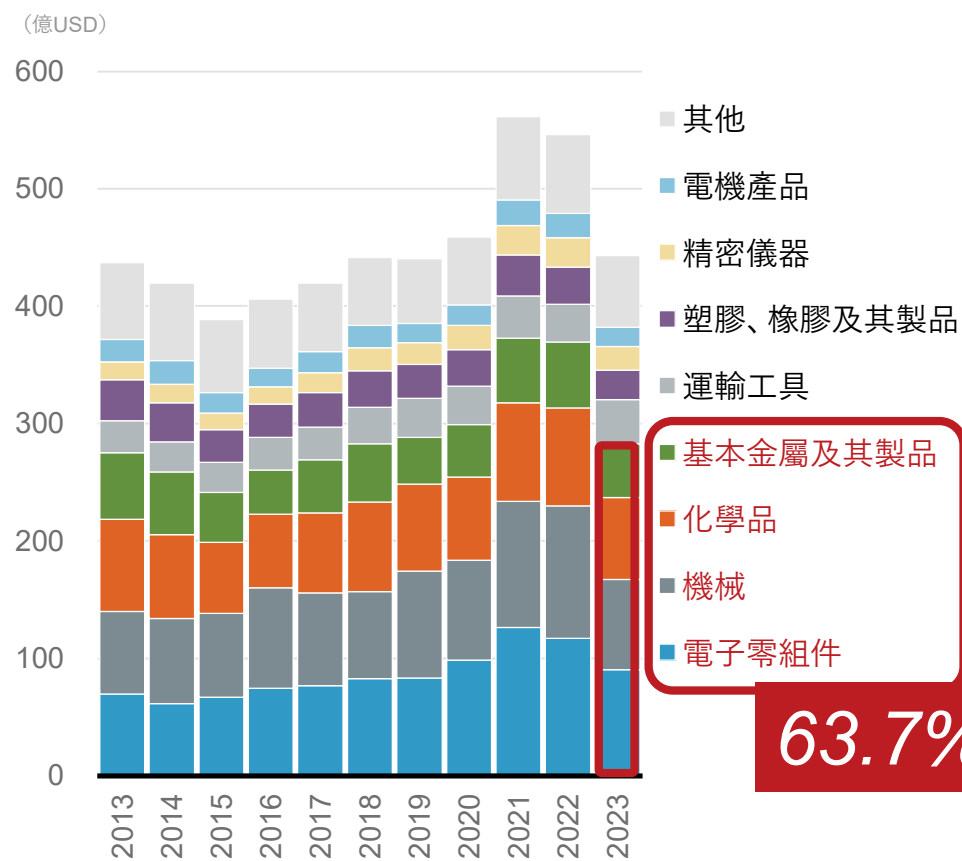
台日貿易關係

- 出口：「電子零組件」，「資通與視聽產品」，「基本金屬及其製品」，「機械」，佔**73.7%**
- 進口：「電子零組件」，「機械」，「化學品」，「基本金屬及其製品」，佔**63.7%**
半導體製造設備，材料等原材料的進口佔進口的大部分

對日本出口趨勢（貨品分類）



自日本進口趨勢（貨品分類）



台日貿易在世界中的定位

- 日本是台灣第3大貿易夥伴，台灣是日本第4大貿易夥伴
- 台灣在日本企業計畫拓展海外業務的國家中，2023年時台灣排名第8
儘管由於地緣政治的考量，問卷回答率低於過去，但台灣仍被視為重要地區

台灣貿易總額 國家排名前5名

() 括弧內為占總額的比率

	第1名	第2名	第3名	第4名
2021	中國大陸+香港 (33.0%)	美國 (12.7%)	日本 (10.3%)	韓國 (6.1%)
2022	中國大陸+香港 (29.9%)	美國 (13.3%)	日本 (9.7%)	韓國 (6.2%)
2023	中國大陸+香港 (28.6%)	美國 (14.9%)	日本 (9.7%)	韓國 (5.9%)

日本貿易總額 國家排名前5名

() 括弧內為占總額的比率

	第1名	第2名	第3名	第4名
2021	中國大陸+香港 (25.2%)	美國 (14.1%)	台灣 (5.8%)	韓國 (5.5%)
2022	中國大陸+香港 (22.3%)	美國 (13.9%)	澳洲 (6.4%)	台灣 (5.5%)

日本企業擴大海外事業版圖 國家 (地區) 排名前10名

() 括弧內為複選方式進行的問卷調查比率

	第1名	第2名	第3名	第4名	第5名	第6名	第7名	第8名
2021	美國 (49.0%)	越南 (46.0%)	中國大陸 (45.9%)	泰國 (38.4%)	西歐 (34.9%)	台灣 (32.3%)	新加坡 (26.8%)	印尼 (25.8%)
2022	美國 (29.6%)	越南 (26.5%)	中國大陸 (26.4%)	EU (20.7%)	泰國 (18.0%)	印尼 (13.3%)	印度 (12.7%)	台灣 (12.3%)
2023	美國 (28.1%)	越南 (24.9%)	中國大陸 (22.6%)	EU (18.6%)	泰國 (17.5%)	印尼 (16.2%)	印度 (13.9%)	台灣 (13.6%)

日本對台灣的投資 (1/2)

- 在對台灣投資金額和件數的國家與地區排名中，日本一直名列前茅
- 投資件數部分，批發業·零售業佔34%

各國與地區對台灣投資金額排名

	第1名	第2名	第3名	第4名
2021	英國海外領土 (27.3%)	荷蘭 (10.0%)	日本 (9.8%)	美國 (9.4%)
2022	丹麥 (26.9%)	英國海外領土 (18.8%)	日本 (12.8%)	澳洲 (8.6%)
2023	新加坡 (26.9%)	德國 (13.8%)	英國海外領土 (10.9%)	加拿大 (9.6%)

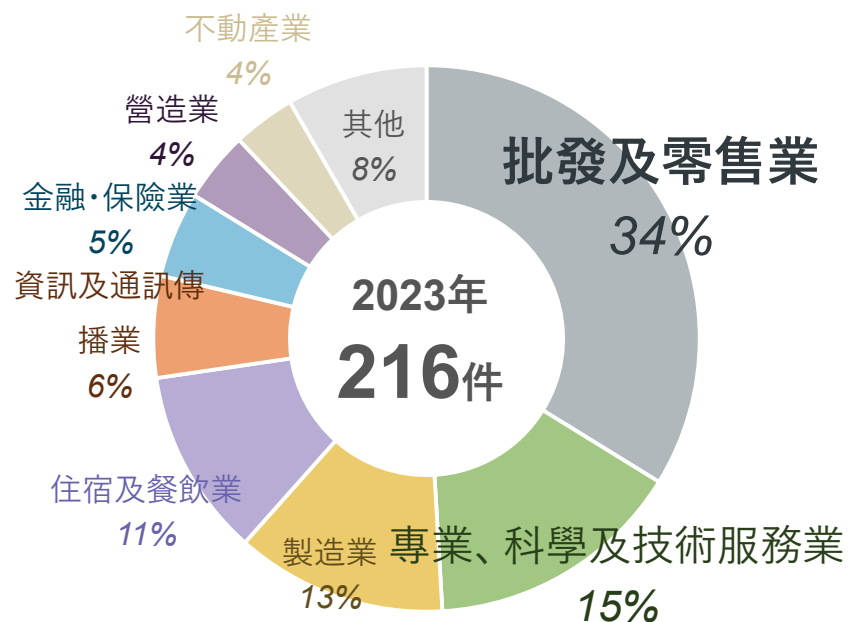
() 括弧內為占投資總額的比率 ※ 2023年 日本名列第8

各國與地區對台灣投資件數排名

	第1名	第2名	第3名	第4名
2021	香港 (25.3%)	美國 (9.3%)	英國海外領土 (8.6%)	日本 (8.5%)
2022	香港 (28.9%)	英國海外領土 (9.4%)	美國 (9.3%)	日本 (8.5%)
2023	香港 (17.1%)	美國 (11.5%)	日本 (9.4%)	新加坡 (9.0%)

() 括弧內為占投資件數的比率

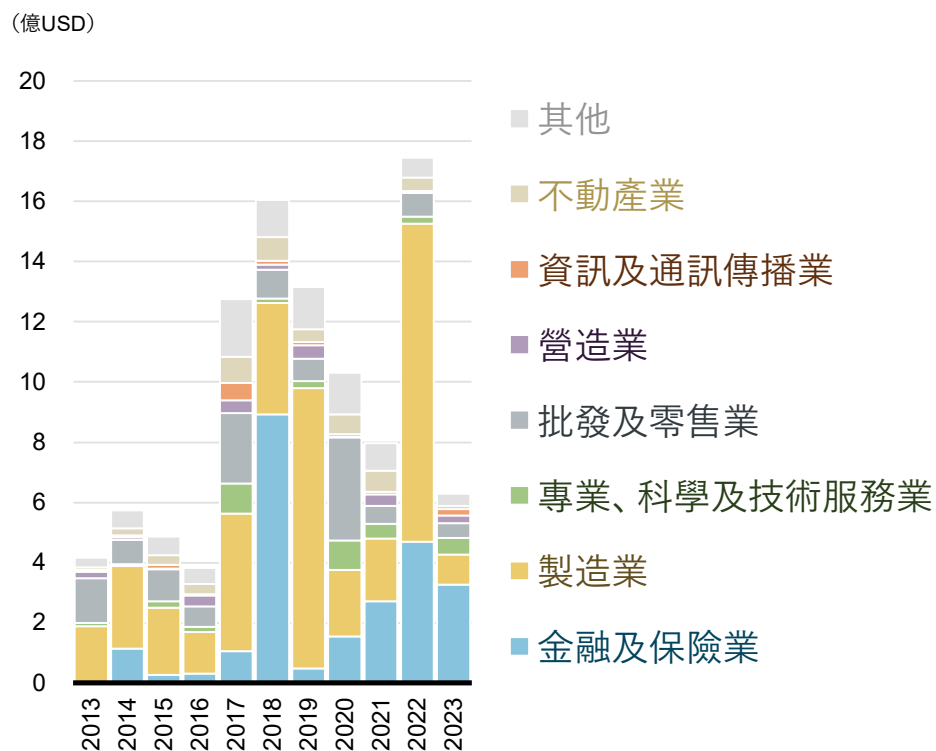
2023年各行業投資件數比率



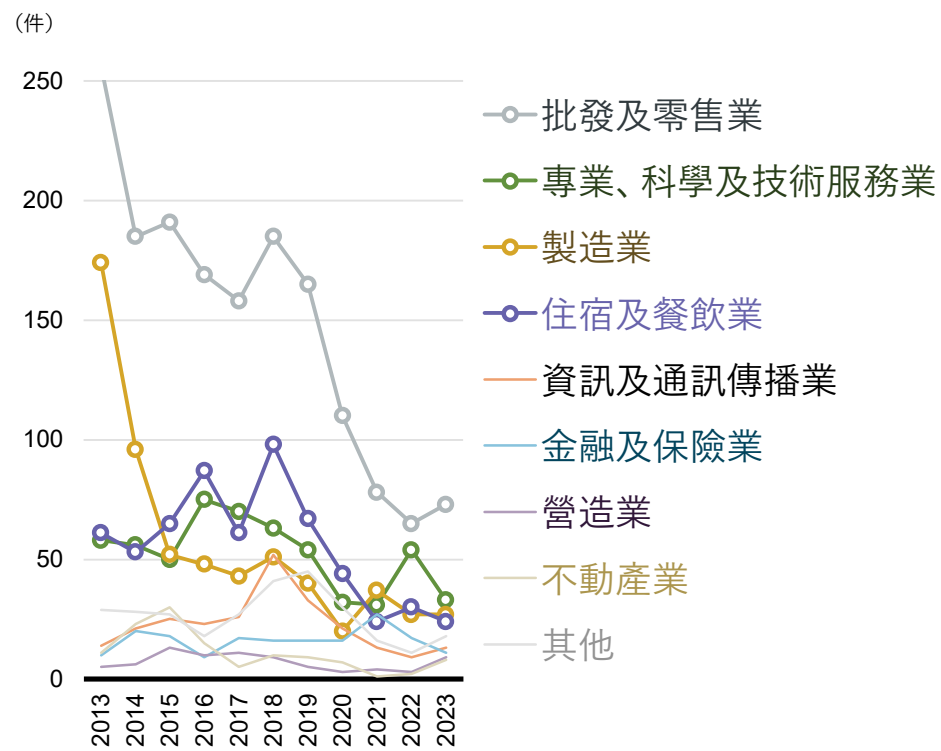
日本對台灣的投資 (2/2)

- 從金額來看，「金融保險業」，「製造業」，「專業，科學及技術服務業」比重較高
- 從件數來看，「批發及零售業」，「專業，科學及技術服務業」，「製造業」的比重較高

各行業對台灣投資趨勢 (金額)



各行業對台灣投資趨勢 (件數)



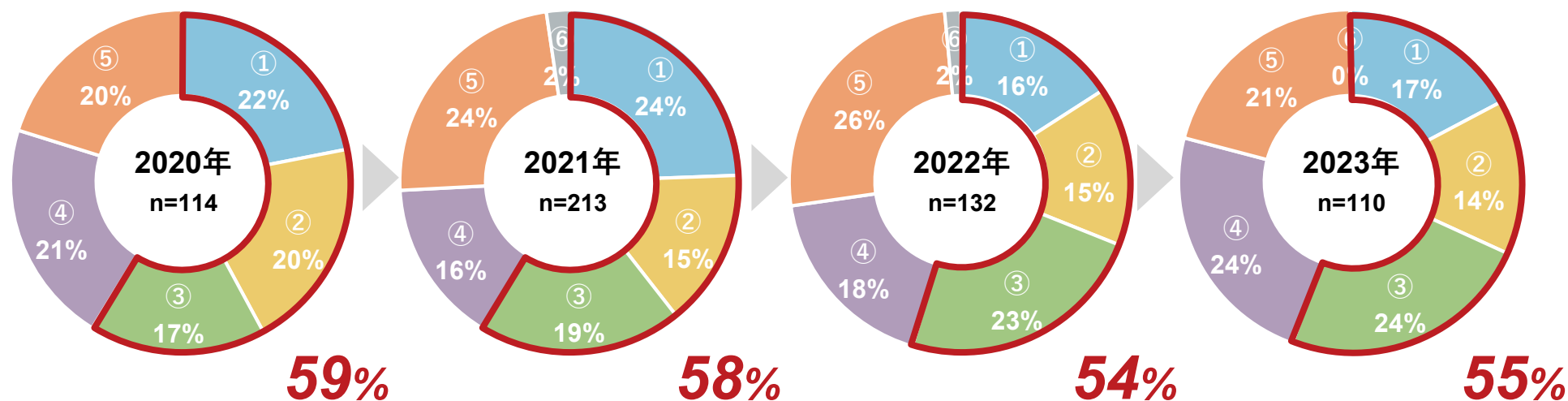
問卷調查結果

近期及未來在台灣本地的投資規劃

N為回答總數。以下同。

2023年11月22日舉辦之「台日投資合作論壇（半導體·EV）」問卷調查結果

- 受訪者中有略多於50%已實行投資或正在進行投資評估
- 在過去兩年裡，「正在評估是否要投資」的比例提升，因此推測積極考慮投資台灣的企業有所增加。



① 已實行投資 ② 投資計畫正在進行

③ 正在評估是否投資

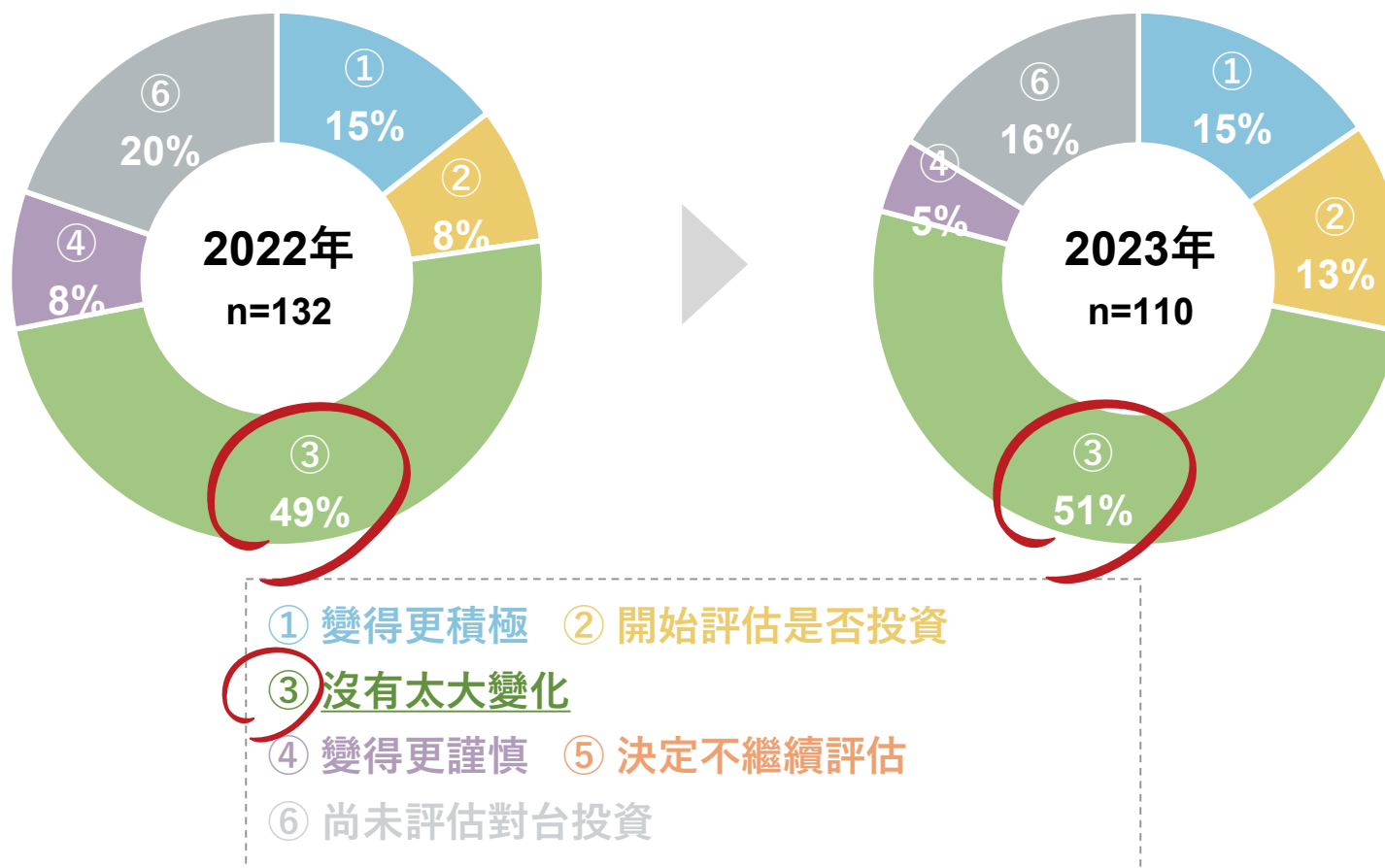
④ 認為有投資的必要，但尚未開始評估

⑤ 不考慮投資 ⑥ 預計縮減台灣業務，以業務效率化為優先考量

對台投資方針及態度與去年相比是否有所轉變

2023年11月22日舉辦之「台日投資合作論壇（半導體·EV）」問卷調查結果

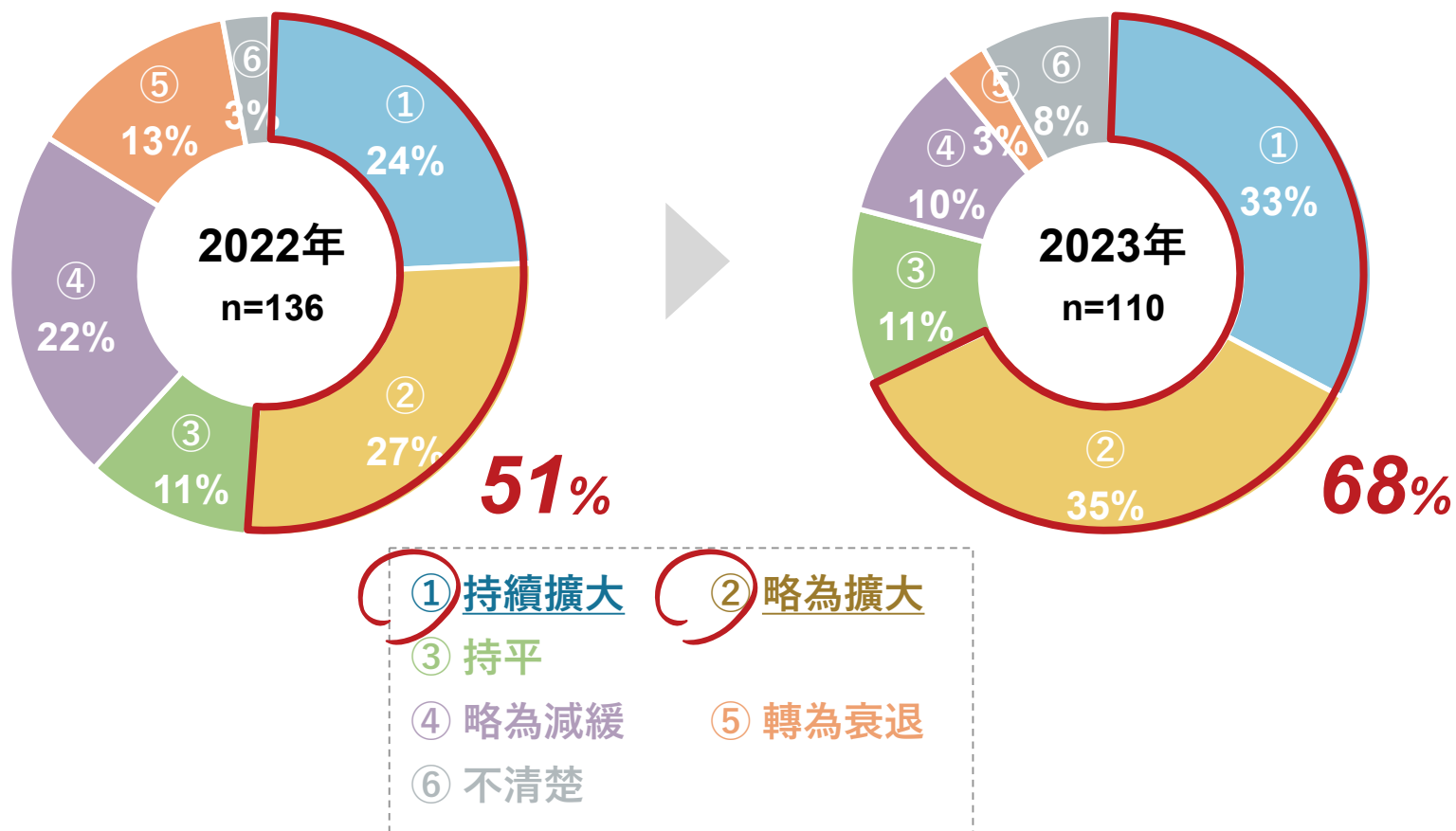
- 半數的受訪者回答投資意願沒有太大變化。
- 由於在兩次的問卷中，「決定不繼續評估」的回答皆為零，投資變得更慎重的回答也小於10%。因此可以解讀為多數的企業對於投資並不消極。



台灣半導體產業未來趨勢

2023年11月22日舉辦之「台日投資合作論壇（半導體·EV）」問卷調查結果

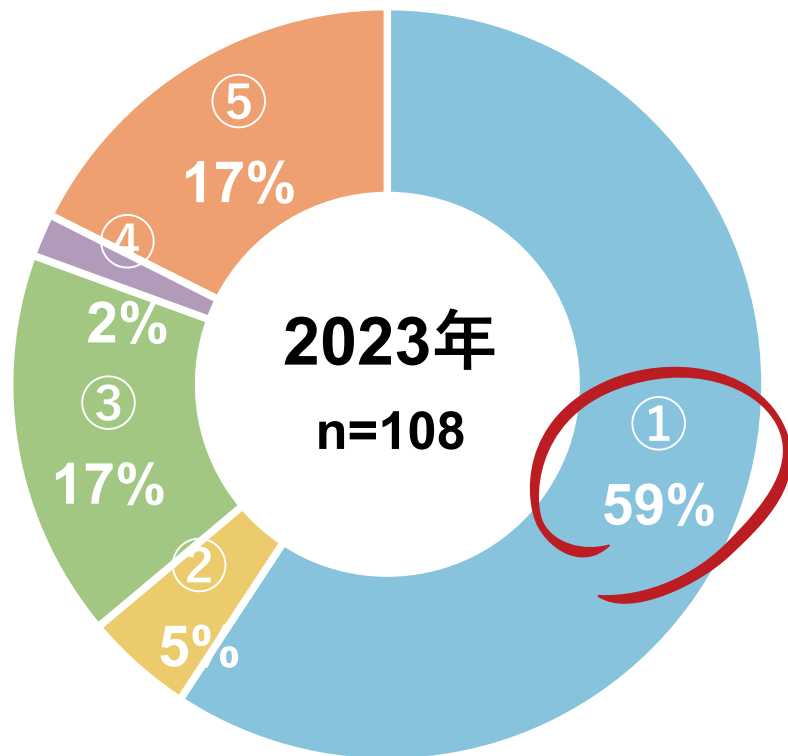
- 「持續擴大」與「略為擴大」的合計為68%(比前次增加17%)。多數受訪者認為半導體產業前景光明。
- 推測有許多公司在2023年處於半導體庫存調整階段，仍對2024年後的未來持積極態度。



在半導體產業中，您認為未來有成長動能的領域為何

2023年11月22日舉辦之「台日投資合作論壇（半導體·EV）」問卷調查結果

- 大多數受訪者都是供應商，「59%的受訪者回答前段製程，後段製程皆會成長」，**這表明未來半導體製造過程中有相當大的商機。**
- 另一方面，17%的受訪者回答「以後段製程為中心成長」，並且許多受訪者對後段製程的期望高於前段製程。



① 前段製程、後段製程皆會成長

② 以前段製程為中心成長

③ 以後段製程為中心成長

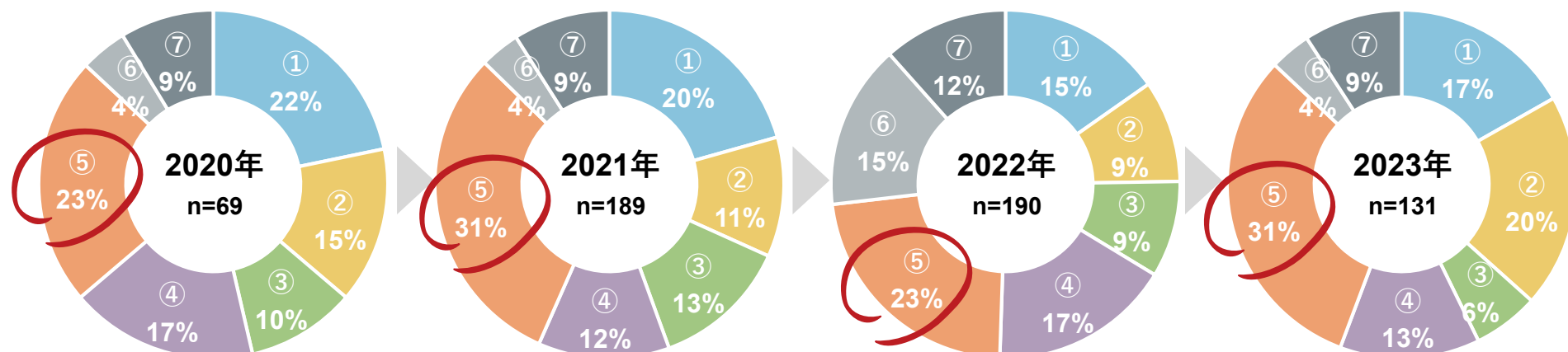
④ 前段製程、後段製程皆難以進一步成長

⑤ 不清楚

實行投資時遭遇的課題，或在評估投資時有所疑慮的面向 (可複選)

2023年11月22日舉辦之「台日投資合作論壇 (半導體·EV)」問卷調查結果

- 「**員工雇用**」在四次問卷中皆為回答最多的答案。
- 其次，**中央或地方政府的許可及執照取得、補助金及稅賦減免等**經濟相關優惠措施較少，兩個答案也有許多受訪者回答。



① 中央或地方政府機關的許可及執照取得(建築、消防、環境etc.)

② 補助金或賦稅減免等、經濟相關優惠措施較少

③ 水電瓦斯等基礎設施的確保

④ 尋找及取得工廠興建用地

⑤ **員工雇用**

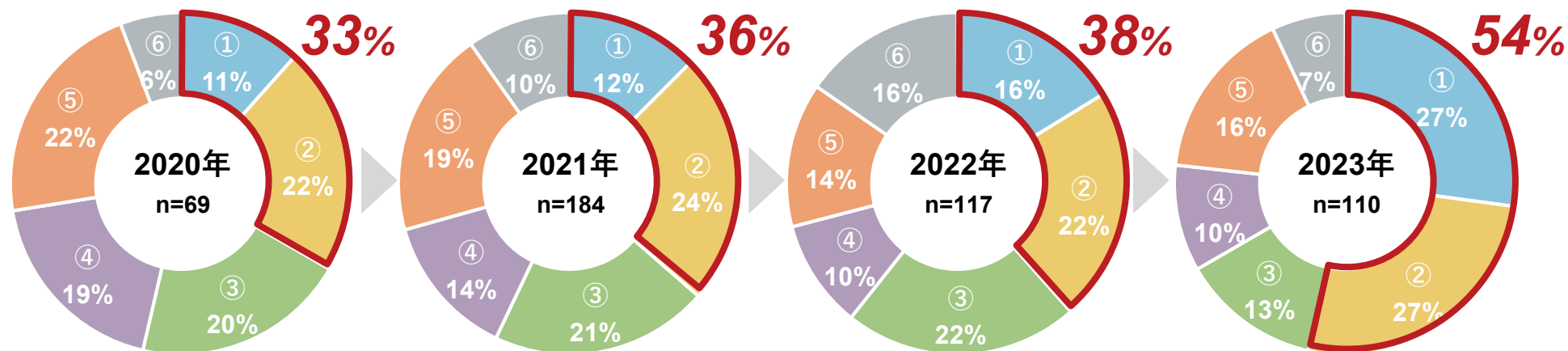
⑥ 建置物流網絡(運輸手段、成本等)

⑦ 其他

評估投資時，與當地半導體製造商往來所面臨之相關課題 (可複選)

2023年11月22日舉辦之「台日投資合作論壇 (半導體·EV)」問卷調查結果

- 回答①，②的比率有年年增加的趨勢，今年升至54%。
- 特別是2022年至2023年的增長，推測是由於處於當前半導體庫存的調整階段，價格要求越來越嚴格，對於新工廠的投資，向供應商披露的資訊有限等背景因素所導致。



- ① 無從得知製造商的需求預測及設備投資計畫，無法彈性因應其需求
- ② 價格條件相對嚴苛(收益性低)，投資回收期間長
- ③ 新增產線及產品認證的取得時間過長(每個工廠需各別取得認證、測試產線亦需)
- ④ 增產或增加庫存要求過於緊急
- ⑤ 品質控管所需成本高(購買分析設備、操作機台的專業人員之人事成本)
- ⑥ 其他

免責聲明

© 2024 日商瑞穗銀行股份有限公司

1. 法律、會計相關建議

本資料所載資訊，不包含法律、會計、稅務上之相關建議。
有關法律、會計、稅務上之處理，請另行諮詢個別專家意見。

2. 保密義務

本資料對貴公司揭露之資訊，貴公司負有保密義務。
相關資訊，僅供貴公司內部使用，禁止揭露予第三人。

3. 著作權

本資料所載資訊之著作權歸屬本行所有。
無論任何目的，未經本行許可，不可複寫、複製、引用、轉載、翻譯及出借本資料之部分或全部。

4. 免責事項

本資料所載資訊是基於可信資訊的基礎上製作，惟本行並不保證資料所載內容之正確性、信賴性或完整性。
在進行交易時，請貴公司自行判斷。因本資料所載資訊所產生之損害，無論其內容為何，本行概不負其責。